

可焊性测试仪原理 易弘顺电子 长治可焊性测试仪

产品名称	可焊性测试仪原理 易弘顺电子 长治可焊性测试仪
公司名称	苏州易弘顺电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区新都银座3号楼1502室
联系电话	18094330000 18094330000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州易弘顺电子材料有限公司

沾锡天平工作过程：

可依据国际规格、日本规格进行可焊性测试及评价。

用于表面封装元件焊锡膏的可焊性和反射流焊接的升温信息下的可焊性、润湿性的测试及评价。

在焊锡急速加热时，短时间内对封装元件的可焊性进行测试及评价。

使用焊锡小球铝块夹具，可对表面封装元件印刷电路板的金属通孔的可焊性进行评价。

对在氮气环境中的可焊性进行测试及评价。

可通过电脑，沾锡天平，对浸润时间，对应力，表面张力，接触角度等进行分析，并可将得到的数据重迭在一起进行比较、分析。

可作为浸渍试验装置和扩张润湿装置使用（选择）。

什么叫沾锡天平，可焊性测试仪原理，沾锡天平是干嘛用的？

沾锡天平是对焊锡、焊锡膏、助焊剂等焊接材料和电子元件以及与印刷电路板焊接的可焊性进行评价的测试仪。此装置对开发产品的评价，元件、材料的品质管理以及焊接工程管理质量的提高，作出了极大的贡献，在日本国内外被广泛应用，并得到好评。也是对无铅化的各种产品进行可焊性评价适合，可焊性测试仪作用，可靠的装置。

什么叫沾锡天平，沾锡天平是干嘛用的？

焊锡能力测试 SOLDERABILITY TESTING 錫锡能力测试仪又称为沾锡平衡仪(WETTING BALANCE)，长治可焊性测试仪，其基本流程是一个上升的锡槽/锡球与待测焊接面接触后，仪器记录锡对测试面所产生的应力反应，直到后力量达于锡张力平衡后测试停止，这个流程我们称为沾锡平衡(WETTING BALANCE)。

可焊性测试仪原理-易弘顺电子(在线咨询)-长治可焊性测试仪由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。“可焊性测试仪,自动光学检测仪,选择性波峰焊,自动插件机”选择苏州易弘顺电子材料有限公司，公司位于：昆山开发区新都银座3号楼1502室，多年来，易弘顺电子坚持为客户提供好的服务，联系人：沈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。易弘顺电子期待成为您的长期合作伙伴！